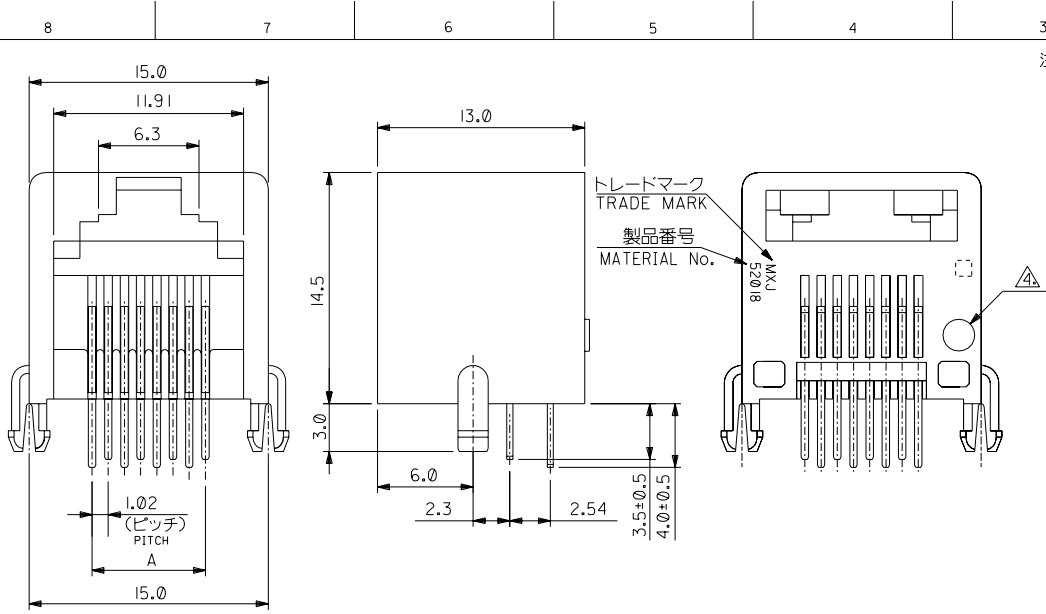


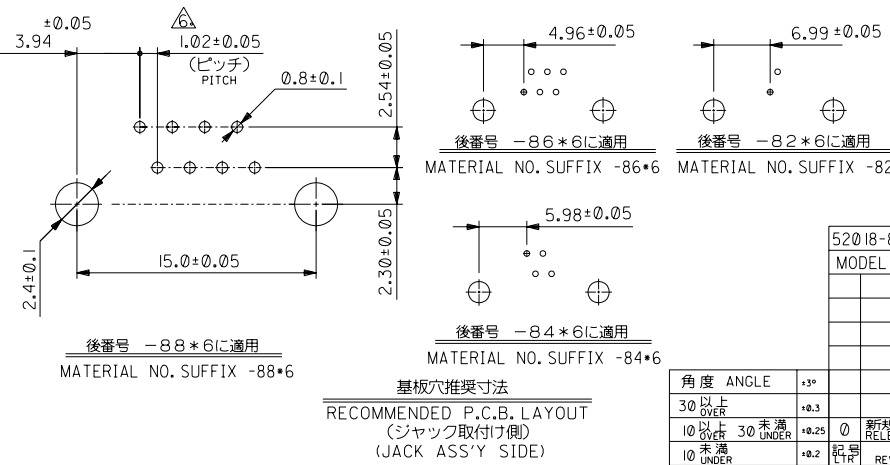
ENG. NO. SD-52018-001

EDP NO.

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



- 注) NOTES
- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ仕様 PLATING
接点部 : 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 鍍メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA : TIN 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE : NICKEL 1.0µmMIN.
 - 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- △ 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.
YELLOW : 0.1µmMIN. GREEN : 0.38µmMIN.
オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.
ORANGE : 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
 - 公差非累積。
NON-ACCUMULATIVE
 - 本製品は 52018-8**5 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-8**5.



52018-8**6	ポジション	極数	1.27	52018-8846
MODEL NO.	POSITION	CIRCUITS	0.76	-8836
			0.38	-8826
			0.1	-8816
			1.27	-8646
			1.27	-8446
			1.27	52018-8246
		(A)		
			金メッキ厚 (µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)	製品番号 MATERIAL No.
			注参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
			仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART
			適用電線範囲 WIRE RANGE	EDP. NO. —
			被覆外径 INS. RANGE	ENG. NO. SD-52018-001
			DRAWN BY 04/04/28 M.NABEL	REV 0
			CHK'D BY 04/04/28 K.TOJO	TITLE 名称 MODULAR JACK HOUSING ASS'Y -LEAD FREE-
			APP'D BY 04/04/28 M.SASAO	尺度 SCALE 4 - 1
角度 ANGLE	±3°			
30以上 OVER	±0.5			
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25	0	新規作成 RELEASED	02004-40351
10未満 UNDER	±0.2		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD
一般公差 GENERAL TOLERANCES			DR. CHK.	日付 DATE
				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。 MXJ-8